

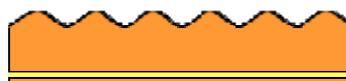
MT18SD-H-T5

- ・ MicroThin は18 μ mのキャリア銅箔が付いている極薄銅箔です。
MicroThin is ultra thin foil with 18 μ m carrier foil.
- ・ コアレス基板工法に適しています。
Suitable for core-less process

用途/Application

- ・ 半導体パッケージ基板
/Semiconductor Package
- ・ コアレス基板
/Core-less substrate

構成/Composition



生産拠点/Production Site

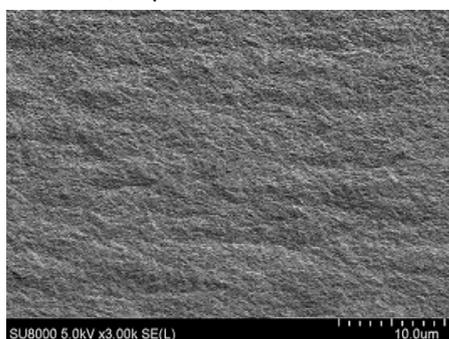
- ・ 日本 / Japan

代表的特性値/Representive date

	μ m	Area weight (g/m ²)	Deposited side Rz(μ m)	Tensile Strength (N/mm ²)	Elogation (%)	Peel Strength (kg/cm) ^{@FR-4}
MT18SD-H-T5	5	40	1	—	—	—

※表中の数値は代表値です。保証値ではありません。
This is representative date, not guarantee.

析出面/deposited side



剥離面/Releasing side

